

대한민국특허청 (KR)
공개실용신안공보 (U)

제 716 호

①InL CL*
H 01 L 21/56

②공개일자 1994 1 3

③출원일자 1992 6 10

④공개번호 84-1979

⑤출원번호 92-10286

심사청구: 없음

⑥고안자 박 준 수 서울특별시 강남구 역삼동 현대빌라 107-202

⑦출원인 금성일렉트로닉스 주식회사 대표이사 윤 경 환

충청북도 청주시 남정동 50번지

⑧대리인 변리사 박 장 원

(전 2 단)

⑨반도체 패키지

⑩요 약

본 고안은 반도체 패키지의 구조에 관한 것으로 반도체 패키지에 있어서, 반도체 칩이 부착 고정되는 리드 프레임의 제단과 상기 칩에 와이어 본딩되는 다수개의 외부연결 리드가 패키지의 저면으로 노출되도록 리드프레이밍의 상부측만 에폭시 몰딩 컴파운드로 몰딩하여 구성한 것이다.

즉 리드 프레임은 기존의 상부측은 에폭시 몰딩 컴파운드로 몰딩하고 하부측은 제단로서 인접솔레이션 역할을 하도록 함으로써 패키지의 전체적인 두께를 보다 작게하며 경박단소화에 기여하고, 실장율을 보다 높일 수 있다는 효과와 아울러 포밍공정이 저지되는 등 제조공정이 단순화되며, 칩의 전기적인 특성이 보다 좋아지는 등의 여러 효과가 있다.

실용신안 등록청구의 범위

1. 반도체 패키지 구조에 있어서, 반도체 칩(11)이 부착 고정되는 리드 프레임의 패들(12)과 상기 칩(11)이 와이어 본딩되는 다수개의 외부연결 리드(13)가 패키지의 측면으로 노출되도록 리드 프레임의 상부측만 에폭시 본딩 접착층(14)로 본딩하여 구성함을 특징으로 하는 반도체 패키지.

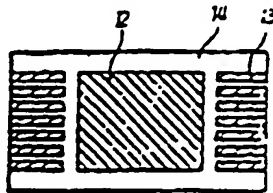
2. 제1항에 있어서, 상기 리드 프레임은 그의 패들(12)과 외부연결 리드(13)가 수평상태로 형성되거나, 또는 패들(12)을 들어올린 업-셋구조로 형성됨을 특징으로 하는 반도체 패키지.

* 참고사항: 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면의 간단한 설명

제3도는 본 고안에 의한 반도체 패키지의 구조를 보이는 도면으로서, 제3도는 제2도의 거면도, 제4도는 본 고안에 의한 반도체 패키지의 실장상태를 보인 단면도.

제3도



제4도

